部品内蔵基板向けはんだペースト技術

日渡　逸人 *

Solder Paste Technologies for Embedded Substrate

Hayato HIWATASHI*

* 千住金属工業株式会社ハンダテクニカルセンター（〒 120-8555　東京都足立区千住橋戸町 23 番地）
*Solder Technical Center, Senju Metal Industry CO., LTD. (23, Senju Hashido-cho Adachi-ku Tokyo 120-8555)